

苏州华源控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：002787

证券简称：华源控股

编号：2025-IR005

投资者关系 活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
参与单位名称 及人员姓名	扬帆智赢：王晓千，孔万林 安固创投：吕忠 开源证券：郭彬
时间	2025 年 12 月 8 日 下午 14:30——16:00
地点	腾讯会议
上市公司接待 人员姓名	邵娜，张健
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p><b>1、华源控股转型半导体领域，在人才储备与布局方面有何规划与成果？</b></p> <p>答：公司围绕半导体战略转型，已初步构建了层次清晰、优势互补的人才布局，核心配置如下：</p> <p>半导体事业部负责人、华源半导体执行董事张健博士，毕业于新加坡国立大学化学系。张健博士曾先后任职于全球前五大晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries）新加坡公司、港股上市公司瑞声科技，在工艺、研发、生产、管理等领域积累了深厚的实战经验，同时拥有广泛的半导体产业人脉资源，为业务战略落地提供核心领导力支撑。</p> <p>公司独立董事陈伟教授，是新加坡国立大学化学系、物理学双聘教授，现任该校理学院副院长、教务长讲席教授。陈伟教授长期聚焦新型功能材料在半导体电子器件、光电器件、类脑计算器件等前沿领域的应用研究，兼具扎实的理论功底与丰富的产学研整合资源，为公司技术路线选择与创新突破提供权威学术指导。</p> <p>此外，我们还集聚了以中国台湾产业人才的顾问团队，以及以新加坡产业人才的技术支持团队，形成专业化、国际化的执行支撑体系。同时，公司将充分整合项目公司原</p>

有核心团队，通过建立科学的考核与激励机制，最大化激发团队成员的主观能动性，为半导体业务的持续发展筑牢人才根基。

**2、公司公告拟设立的芯源科技跟已经设立的华源半导体有什么关系？**

答：“苏州芯源科技有限公司”是公司在工商注册阶段的预核准名称，而“苏州华源半导体有限公司”是经市场监管部门最终核准登记的正式名称——两者实际指同一家公司，未来不会再设立“苏州芯源科技有限公司”。苏州华源半导体有限公司将作为华源控股半导体事业部的实体运营载体，全面承接半导体相关业务的具体开展。

**3、公司投资无锡暖芯半导体科技有限公司，其具体的业绩情况如何？交易对价多少以及后续安排？**

答：公司下属基金购买无锡暖芯半导体科技有限公司 46%的股权，近期已完成工商变更。具体的交易对价是整体估值 1 亿元，对应 46%股权为 4,600 万元，业绩承诺为 2025、2026、2027 年三年的年平均净利润不低于 1,000 万人民币。公司不排除后续进一步购买其股权，实现控股。具体进展及业绩情况请以公司后续公告为准。

**4、与无锡暖芯合作之后，在 chiller 这块有什么大的战略目标么？**

答：依托双方合作与华源的资源赋能，我们计划在 3-5 年内助力无锡暖芯在 chiller 赛道实现行业地位跃升，目标成为 chiller 国内第二梯队核心企业。客户拓展方面，我们将重点攻坚国内逻辑芯片、存储芯片领域的头部企业，凭借技术协同优势与定制化解决方案，力争在核心客户供应链中获取稳定份额，夯实细分市场竞争力。

**5、上海寰鼎的 RTP 具体是什么设备？国内的竞争对手有哪些？如何在竞争中保持先进性？其 wafer solution 又是什么？**

答：上海寰鼎的 RTP（Rapid Thermal Processing，全称快速退火炉），是半导体制程中的关键热加工设备。它通过快速升温/降温及精准温度控制，在晶圆表面形成局部高温环境，核心价值在于“不损伤晶圆底层结构的前提下，高效完成掺杂激活、薄膜改性等关键工艺”，为半导体制造提供核心热加工支撑。

目前国内 RTP 设备的主要公司包括北方华创、屹唐股份等企业。上海寰鼎的 RTP 设备聚焦第三代半导体制程领域，凭借对细分赛道的深耕，已获取市场份额。

上海寰鼎的 wafer solution 主要包含两款核心产品：一是 thermal coupling wafer（热耦合晶圆），用于核心制程及先进封装设备的温度校准，保障工艺温度精准度；二是 clean wafer（清洁晶圆），主要用于设备腔体的清洁维护。这两款产品属于半导体制程中的关

	<p>键耗材，目前正处于大陆市场推广阶段。</p> <p><b>6、公司目前的股份回购计划，主要是基于什么考虑？</b></p> <p>答：公司 2025 年 11 月 28 日刚完成了 3,990 万元的回购股份计划，基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，公司近年来积极推进股份回购及注销计划。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金及自筹资金 3,000 万至 6,000 万，以集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购股份的用途主要是进行股权激励或注销。</p> <p><b>7、公司包装技术优势表现在？公司专利情况？</b></p> <p>答：公司将技术革新视为推动公司进步的源动力，一直致力于包装领域相关技术的研发 和创新工作，并逐步建立起国内先进的技术研发中心，投入大量资金不断改造公司生产设备及工艺技术，取得大量技术成果及多项专利技术，拥有一支具备个性化模具设计与柔性智能装备丰富经验与技术功底的研发团队，在各类功能性金属制品与个性化结构件的研发和制造方面有足够的技术积累和生产经验，拥有 400 多项授权专利技术，其中发明专利 70 余项。公司具备金属材料异形复杂拉伸、模压成型、高频焊接、多工序一线成 型、多模级进等多种金属材料深度造型工艺能力。</p> <p><b>8、公司在海外市场拓展及海外布局？后续是否有加大海外市场投入的计划？</b></p> <p>答：公司客户基本上都是国际公司及部分全球 500 强企业，在业务发展过程中，以主业为依托，也在持续寻找海外的一些增长，不管是传统业务还是其他新业务的增长点，一直在寻求机会。目前公司已经设立了新加坡华源，努力寻找和我们客户在东南亚及全球的一些合作，海外市场持续开拓中。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 12 月 8 日